

お客様情報アップデート XCU2001-01

PCN2000-08 についてのサンプル可能時期アップデート

概要: 2001年3月にこのお客様情報アップデート(XCU2001-01)は、Virtex™ デバイスの0.22μ/0.18μ 6層メタルハイブリッドプロセスで製造されたサンプルと量産可能時期について報告しました。その後、これが変更になり、新たな可能時期は以下のようになります。サンプルまたは量産用デバイスを必要とされる場合は、[ザイリンクス 販売代理店](#)までご連絡ください。また、トレーサビリティについての項目が含まれています。

件名: 0.22μ / 0.18μ 6層メタルハイブリッドプロセスで製造された Virtex コマーシャル (C グレード および I グレード) 製品のサンプル可能時期の通知。

対象製品: 次の Virtex 製品ラインのコマーシャル (C グレード および I グレード) 製品が対象です。XCV300、XCV400、XCV600、XCV800、および XCV1000。この通知は Virtex-E または Virtex-II デバイスには該当しません。

キー デート: ザイリンクスは 0.22μ / 0.18μ プロセスで製造された Virtex 製品を以下の日程で出荷を始めます。

デバイス	サンプル可能時期	量産可能時期
XCV300	2004	2004
XCV400	March 2003	May 2003
XCV600	April 2003	June 2003
XCV800	May 2003	July 2003
XCV1000	2005	2005

上記は 2003 年 2 月 26 日現在の日付です。

トレーサビリティ：これらのデバイスはパッケージ トップマークの 2 行目のパッケージ/ピンコードとデートコードの間の 3 つのアルファベットで識別可能となっています。この 3 文字コードの 3 番目のアルファベットが「S」であれば、0.22 μ / 0.18 μ 6 層メタル ハイブリッド プロセスで製造されたことを示します。3 番目のアルファベットが「P」であれば、0.22 μ プロセスで製造されたことを示します。次の例を参照してください。

パッケージ トップマークの例

	トップマーク表示	トップマークの意味
Line 1:	XCV300 TM	Xilinx Device Type BG432 = Package Type
Line 2:	BG432AFS0101	A = Circuit Stepping F = UMC Wafer Fab S = 0.22 μ / 0.18 μ Fab Process 0101 = Date Code
Line 3:	F2083509A	Assembly Lot Number
Line 4:	6CES	6 = Speed Grade C = Temperature Grade ES = Engineering Sample

ハイブリッド プロセスの認定サンプルは、パーツナンバの後の「ES」サフィックスでオーダーできます(例：XCV300-5BG432CES)。認定サンプルではパッケージ トップマークの 4 行目に「ES」が含まれます。量産デバイスには「ES」のマークがありません。

レスポンス：この通知に対するレスポンスは必要ありません。サンプルまたは量産用デバイスを必要とされる場合は、[ザイリンクス 販売代理店](#) までご連絡ください。ご不明な点、ご質問等がございましたら、Xilinx, Inc. 品質保証部まで Email pcn@xilinx.com または直接 FAX (408) 369-1718 にてご連絡下さい。